

NATS Series

IGBT/SiC パワーモジュール検査装置

IGBT/SiC POWER MODULE TEST SYSTEM

NATS-1000

IGBT/SiCモジュール
絶縁/静特性/動特性 自動検査装置
Si-IGBT/SiC-MOSFET
Power Module ISO/DC/AC Automated Test System

For
Mass-Production



● インライン外観イメージ
In-line inspection system image
(Appearance varies depending on system configuration)



● Trolley connection

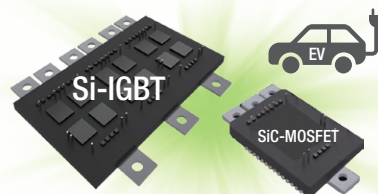


● LOADER接続イメージ
Loader type inspection system image
(Appearance varies depending on system configuration)

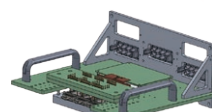
特徴 | Features

- 絶縁検査 (ISO)
Isolation Test (ISO)
- 静特性検査 (DC)
Static Characteristic Test (DC)
- 動特性検査 (AC)
Dynamic Characteristic Test (AC)

- 高温検査 ~175°C (~200°C)
High Temperature Test (up to 200°C)
- 高スループット
最大144UPH (25秒/ユニット)
High-throughput up to 144UPH (25sec/unit)
- 低LS 4.5 nH
Low stray inductance 4.5 nH
- 自動ライン拡張可能
Automatic Line Expandable
- IEC60747準拠測定
IEC60747 Compliant Measurement
- AOI/そり検査/レーザーマーキング
AOI/Warpage test/Laser Marking

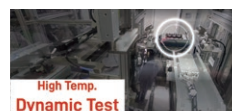


ユニバーサル治具 | Universal Fixture



- 低LS値を実現し、高精度検査に対応
Provide high-accuracy test with a low LS
- ワンタッチ着脱治具機構
Easy replacement and improved JIG maintainability

高スループット | High Throughput



- 最大144UPH (25秒/ユニット) の高スループット検査を実現
Capable of high-throughput test up to 144UPH (25 seconds/unit)

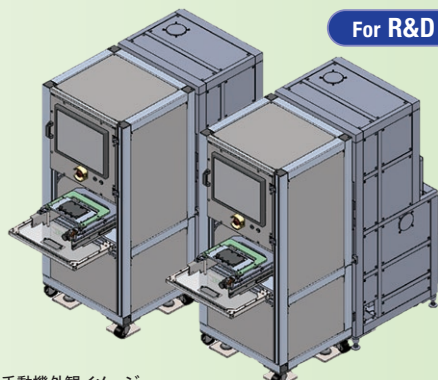
高温検査 | High Temperature Test

- 200°Cまでの高温検査に対応
Capable of high temperature test up to 200°C

NATS-1630/1730

IGBT/SiC パワーモジュール
動特性手動検査装置
Si-IGBT/SiC-MOSFET
Power Module AC Manual Test System

For R&D

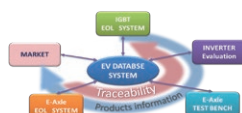


- 手動機外観イメージ
絶縁用、静特性用検査装置も構築可能
Manual inspection system image
Isolation/Static characteristic test system configuration available
(Appearance varies depending on system configuration)

ワイドバンドギャップな計測技術!!

We offer advanced measurement technologies such as wide band gap.

データトレーサビリティ | Data Traceability



- 外部PCやcloud等の上位データ管理システムとの連携が可能
Available to link with external PCs and upper data management systems

メカニズムセレクト | Configuration Selection



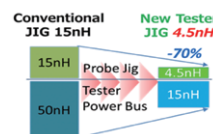
手動検査仕様
Manual Test System



自動検査ライン仕様 NATS-1000
Auto In-Line Test System

- 手動検査、インライン、ローダー&アンローダー仕様が選択可
Selectable Manual/In-Line/Loader & Unloader Configuration

低LS 4.5nH | Low stray inductance



- SiC-PM検査に必要な低LSを治具/テスターで実現!!
Achieved the low LS required for SiC module inspection with jigs and testers!!

簡単操作 | Easy Operation



- プログラム不要で簡易な操作性を実現
Easy operability with no programming required
- 簡単操作で波形をワンタッチ解析
One-touch analysis of waveforms with easy operations

KGD Test | Known good die Test

- Wafer製造 | Wafer manufacturing
- Wafer検査 | Wafer inspection
- Waferダイシング | Wafer Dicing
- 従来
- アッセンブリ
- 製品検査
- 製品AOI
- トレイソート・AOI
- チップ個片検査
- チップ個片AOI



Wafer検査からの脱却!! Without Wafer level Test

